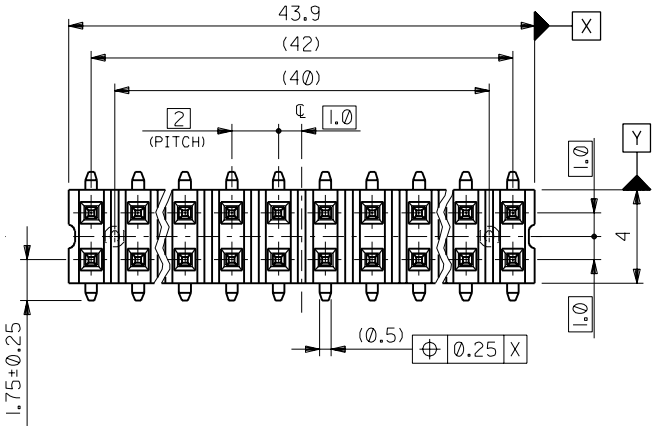
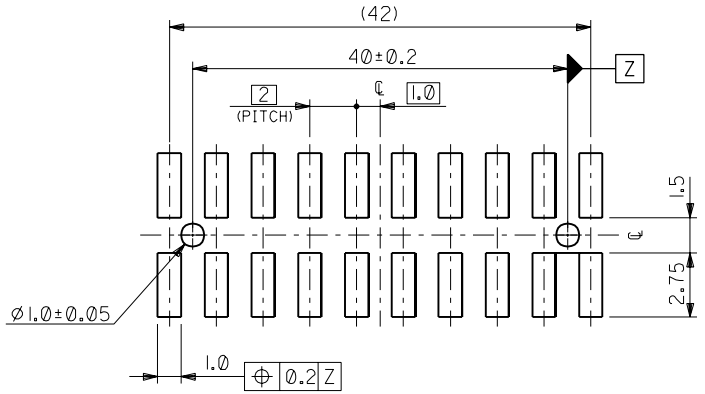
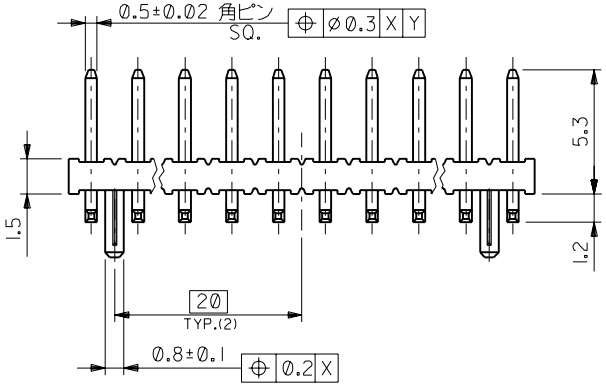
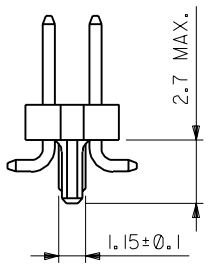
DWG. NO. SD-87267-4450









注記)
NOTES

1. 材質
MATERIAL
ハウジング：耐熱性ナイロン、UL94V−0、黒
HOUSING : HIGH TEMP NYLON , UL94V-0 , COLOR - BLACK
ピン　　：燐青銅（510）の0.5mm角ピン
PIN : 0.5mm SQ.PHOSPHOR BRONZE 510
2. メッキ仕様
PLATING
接点部 ：金メッキ0.38 μmMIN.
CONTACT AREA:GOLD 0.38 μmMIN.
半田付け部：半田メッキ1.9 μmMIN.
SOLDER TAIL AREA:TIN-LEAD 1.9 μmMIN.
下地メッキ：ニッケルメッキ1.27μmMIN.
UNDER-PLATING:NICKEL 1.27 μmMIN.
3. 推奨基板厚
RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.6±0.1mm MIN.
4. テールの平坦度
TAIL COPLANARITY
テールの平坦度は0．15MAX．とする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.15MAX.

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 OVER 30未満 UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
0	新規作成 RELEASED (T40043)	S.M J.M	'94/01/26

材料 MATERIAL 注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH 注記参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE —
被覆外径 INS. RANGE —
DRAWN BY S.Ishigama
CHK'D BY
APP'D BY
尺度 SCALE 5-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
"MILLI-GRID"
2.0mm DUAL ROW
SMT HEADER (WITH PEG)

DWG. NO. SD-87267-4450
REV 0

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

ZF3C110.0373S87267.DGN

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32